证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2024-009

上海伟测半导体科技股份有限公司关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、相关情况概述

为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）及南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）日常生产经营及相关项目建设、投资等相关资金需求，便于公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司 2024 年拟向合作银行申请总额不超过人民币 11.90 亿元银行授信额度，用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。具体明细如下：

单位：万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	交通银行股份有限公司上海张江支行	20,000.00	1 年	公司
2	中信银行股份有限公司上海分行	15,000.00	1 年	公司
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	10,000.00	1 年	公司
4	招商银行股份有限公司上海分行	10,000.00	1 年	公司
5	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	10,000.00	1 年	公司
6	中国农业银行股份有限公司上海川沙支行	5,000.00	1 年	公司
7	招商银行股份有限公司无锡分行新区支行	5,000.00	1 年	无锡伟测
8	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	2,000.00	1 年	无锡伟测
9	中信银行股份有限公司无锡新区支行	10,000.00	1 年	无锡伟测
10	花旗银行（中国）有限公司上海分行	10,000.00	1 年	无锡伟测
11	招商银行股份有限公司南京分行	10,000.00	1 年	南京伟测
12	中国农业银行股份有限公司	10,000.00	1 年	南京伟测
13	中信银行南京分行中山东路支行	2,000.00	1 年	南京伟测
合计		119,000.00		

具体融资金额在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为解决向上述银行申请综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含全资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押金额预计不超过 5,000 万元。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。实际抵押的资产以和金融机构签订的合约为准。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司董事长骆文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押或质押担保合同文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2024-012

上海伟测半导体科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理骆文胜先生不再担任审计委员会委员，选举宋海燕女士担任审计委员会委员，与王怀芳先生、林秀强先生共同组成公司第二届董事会审计委员会。

本次董事会审计委员会委员调整完成后，董事会审计委员会由王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士共同组成（王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士均为独立董事），王怀芳先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2024-013

上海伟测半导体科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）独立董事专门会议审议的情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟测科技”）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司前次日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理。公司 2024 年度日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（2）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事陈凯回避表决。

（3）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：本次日常关联交易的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

（5）本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、本次 2024 年度新增日常关联交易预计金额和类别

本次拟对公司 2024 年度（以下简称“本次交易期间”）与关联方的日常交易情况进行新增的预计。本次交易期间日常关联交易新增的预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年度已预计金额（万元）	2024 年度本次新增预计金额（万元）	本次新增预计金额占同类业务比例	本年初至 2024 年 2 月 29 日与关联人已发生的交易金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	2023 年实际发生金额与同类业务比例	合计预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	强一半导体（苏州）股份有限公司	240.00	260.00	4.64%	0.00	269.81	4.81%	不适用
	上海季丰电子股份有限公司	20.00	80.00	1.43%	0.00	0.32	0.01%	不适用
	圆周率半导体（南通）有限公司	20.00	80.00	1.43%	0.00	14.05	0.25%	不适用
	小计	280.00	420.00	7.49%	0.00	284.18	5.07%	—
向关联人提供劳务	普冉半导体（上海）股份有限公司	2,160.00	5,840.00	7.93%	819.08	2,928.52	3.98%	基于实际业务需进行的预计
	中微半导体（深圳）股份有限公司	75.00	325.00	0.44%	29.69	147.93	0.20%	不适用
	核芯互联科技（青岛）有限公司	90.00	410.00	0.56%	0.97	78.63	0.11%	基于实际业务所需进行的预计
	小计	2,325.00	6,575.00	8.93%	849.73	3,155.08	4.29%	—
合计		2,605.00	6,995.00	—	849.73	3,439.26	—	—

注 1：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，相关预计金额体现在上表“2024 年度已预计金额”一列中。

注 2：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次新增关联交易的预计金额占同类业务比例 = 本次预计金额 /2023 年度经审计同类业务营业收入或采购金额；

注 3：本年年初至 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

注 4：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

3、前次 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	强一半导体（苏州）股份有限公司	300.00	269.81	不适用
	上海季丰电子股份有限公司	100.00	0.32	不适用
	圆周率半导体（南通）有限公司	-	14.05	不适用
	小计	400.00	284.18	—
向关联人提供劳务	普冉半导体（上海）股份有限公司	3,000.00	2,928.52	不适用
	中微半导体（深圳）股份有限公司	200.00	147.93	不适用
	核芯互联科技（青岛）有限公司	-	78.63	不适用
	小计	3,200.00	3,155.08	—
合计		3,600.00	3,439.26	—

注 1：公司已离任董事祁耀亮于 2022 年 7 月开始担任圆周率半导体（南通）有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，圆周率半导体（南通）有限公司因此成为公司的关联方，相关关联交易金额未达董事会审议标准。

注 2：公司董事陈凯于 2023 年 4 月开始担任核芯互联科技（青岛）有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，核芯互联科技（青岛）有限公司因此成为公司的关联方，相关关联交易金额未达董事会审议标准；

注 3：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、关联人基本情况和关联关系

1、普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	普冉半导体（上海）股份有限公司	
公司类型	股份有限公司（上市、外商投资企业投资）	
法定代表人	王楠	
注册资本	75,515,285.00 元人民币	
成立日期	2016 年 1 月 4 日	
住所及主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层整层（实际楼层 8 楼）	
主营业务	半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
实际控制人	王楠	
最近一个会计年度主要财务数据（万元）（未经审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
	总资产	211,455.51
	净资产	192,496.77
	营业收入	112,705.00
	归属于母公司所有者的净利润	-5,207.50

注：普冉股份最近一个会计年度未经审计的主要财务数据来源于普冉股份于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年度业绩快报公告》。

（2）与公司的关联关系：公司董事陈凯担任普冉股份董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：普冉股份为依法存续且经营正常的科创板上市公司，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

2、中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	中微半导体（深圳）股份有限公司	
公司类型	其他股份有限公司（上市）	
法定代表人	周彦	
注册资本	40,036.50 万元人民币	
成立日期	2001 年 6 月 22 日	
住所及主要办公地点	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号景兴海上大厦 2101	
主营业务	集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	
实际控制人	YANG YONG	
最近一个会计年度主要财务数据（万元）（未经审计）	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
	总资产	314,369.76
	净资产	296,565.03
	营业收入	71,356.97
	归属于母公司所有者的净利润	-2,783.43

注：中微半导最近一个会计年度未经审计的主要财务数据来源于中微半导于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度业绩快报公告》。

（2）与公司的关联关系：公司董事陈凯担任中微半导董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：中微半导为依法存续且经营正常的科创板上市公司，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

3、核芯互联科技（青岛）有限公司（以下简称“核芯互联”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	核芯互联科技（青岛）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	胡康桥
注册资本	3,054.780391 万人民币
成立日期	2018 年 12 月 7 日
住所及主要办公地点	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 D2 楼 2701
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	胡康桥
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司董事陈凯担任核芯互联董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：核芯互联为依法存续且经营正常的公司，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

4、强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	强一半导体（苏州）股份有限公司
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人	周明
注册资本	9,716.9418 万元人民币
成立日期	2015 年 8 月 28 日
住所及主要办公地点	苏州工业园区东长路 18 号 39 幢 2 楼
主营业务	研发、加工、生产、销售；半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件，并提供相关产品的售后服务和技术服务；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	周明
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司已离任董事祁耀亮担任强一股份董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：强一股份为依法存续且经营正常的公司，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

5、上海季丰电子股份有限公司（以下简称“季丰电子”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	上海季丰电子股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	郑朝晖
注册资本	11,558.60 万元人民币
成立日期	2008 年 7 月 7 日
住所及主要办公地点	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	郑朝晖
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司已离任董事祁耀亮担任季丰电子董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：季丰电子为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

6、圆周率半导体（南通）有限公司（以下简称“圆周率半导体”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	圆周率半导体（南通）有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	周明
注册资本	3,231.6763 万元人民币
成立日期	2021 年 4 月 27 日
住所及主要办公地点	南通高新区康富路 898 号
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；机械设备研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；有色金属合金销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	周明
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司已离任董事祁耀亮担任圆周率半导体董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：圆周率半导体为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司对 2024 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品或提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

2、关联交易协议签署情况

2021 年 5 月，公司与普冉股份签署了《测试服务合同》，就公司为普冉股份提供集成电路测试相关业务的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至 2024 年 5 月 11 日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。

2022 年 6 月，全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）与普冉股份签署了《测试服务合同》，就南京伟测为普冉股份提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至 2025 年 6 月 9 日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。

2023 年 8 月，全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）与核芯互联签署了《测试服务合同》，就无锡伟测为核芯互联提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至 2026 年 8 月 13 日，若合同期限届满前 30 日内双方未以书面形式终止本合同或订立新合同，则本合同继续有效。

2024 年 2 月，公司与中微半导签署了《委外加工合同》，就公司为中微半导提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至 2027 年 2 月 20 日，若合同期限届满前 30 日内双方未以书面形式终止本合同或订立新合同，则本合同有效期自动延续，每次自动延期 1 年。

除已签署合同外，公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或执行具体的业务订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：

伟测科技 2023 年度日常关联交易及 2024 年度新增日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。

保荐机构对伟测科技 2023 年度日常关联交易及 2024 年度新增日常关联交易预计额度的事项无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

公司代码：688372　　公司简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 113,373,910 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,279,651.20 元（含税）。现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.75%。

如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	伟测科技	688372	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王沛	
办公地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋	
电话	021-58958216	
电子信箱	ir@v-test.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

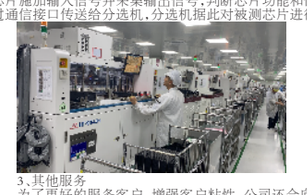
公司主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT 测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖 CPU、GPU、MCU、FPGA、AI 芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片等芯片种类，在工艺上涵盖 5nm、7nm、14nm 等先进制程和 28nm 以上的成熟制程，在晶圆尺寸上涵盖 12 英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品，在下游应用上包括通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

1、晶圆测试

晶圆测试（Chip Probing），简称 CP，是指通过探针台和测试机的配合使用，对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的端点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给探针台，探针台据此对芯片进行打点标记，形成晶圆的 Mapping，即晶圆的电性测试结果。

2、芯片成品测试

芯片成品测试（Final Test），简称 FT，是指通过分选机和测试机的配合使用，对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：分选机将被测芯片逐个自动传送至测试工位，被测芯片的引脚通过测试工位上的基座、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给分选机，分选机据此对被测芯片进行标记、分选、收料或编带。



3、其他服务

为了更好的服务客户、增强客户粘性，公司还会向客户提供测试设备租赁、测试辅材的销售等服务。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司通过自主研发的集成电路测试技术、先进的集成电路测试设备以及高效敏捷的测试生产和技术服务体系，向芯片设计企业、晶圆制造企业、封装企业和 IDM 企业提供晶圆测试、芯片成品测试服务，取得收入、获得盈利。

2、生产模式

公司在与客户确定初步合作关系后，通过签订测试服务协议约定双方的权利义务，客户通常通过下订单的方式来提出测试需求，公司在对自身测试产能、不同种类测试机台进行把控的基础上，根据客户的需求安排相应的集成电路测试，及时处理测试过程中的问题，确保测试服务的有效完成。

公司的测试生产工作主要由各测试工厂来承担，其他部门配合完成，实际操作过程中，公司在接受客户的晶圆或芯片成品来料后，相关部门进行客户的相关产品的信息建档和对来料的检验并排产，生产部门依照排产要求组织测试作业。

3、销售模式

公司测试服务采用直销的销售模式，客户分布区域以长三角地区为主，向南延伸至珠三角地区，向北延伸至北京、吉林等地。

（1）组织架构

公司的销售工作由销售客服部门承担，销售客服部门设置市场销售和客服计划两大职能岗位。市场销售人员主要负责营销方案的制订、新客户的接洽及引进，客服计划人员主要负责投料排产、客户关系维护以及回款管理等。

（2）客户开拓

公司已建立起一支专业能力及行业经验丰富的销售团队，积极主动开发各类新客户，公司在集成电路测试行业的服务品质得到了业内老客户的广泛认可，故公司除了通过主动开发新客户、提升老客户测试产品的产能、开发老客户在新产品方面的测试等方式开拓客户以外，老客户引荐新客户也是公司重要的获客方式之一。

（3）销售定价

公司销售人员经前期洽谈确定客户需求后，与客户协商确定测试服务价格。

4、采购模式

公司的采购类别主要包括测试设备、测试辅材及其他物品的采购。

（1）测试设备

测试设备主要包括测试机、探针台、分选机等，以日本、美国、韩国、中国台湾等国家和地区的进口设备为主，亦有部分国产设备，其中公司采购的分选机主要为国产设备，探针台目前国内尚未有成熟产品故仍以进口为主，测试机中模拟类测试机以国产为主。公司根据自身产能需求、市场需求状况并结合不同设备的交期情况进行下单采购。

（2）测试辅材

测试辅材主要包括探针卡、测试座、治具、包装材料等，主要根据季度或月度的备件计划并结合具体测试项目的需求状况进行采购。

（3）其他物品

其他主要包括日常办公设备、设备维护材料等，主要根据生产及办公的实际需求进行采购。

公司各部门所需原材料均通过采购部门集中采购，并按照公司相应制度文件执行采购制度。

公司已获得 ISO9001、ISO14000 等质量管理体系认证。在新供应商准入方面，除了考察供应商质量、价格、交期、技术水平外，还要求其通过相关行业的质量认证体系，通过资格审查和认证稽核的供应商才能够进入公司合格供应商名录。对于现有供应商，公司定期对供应商进行审核，确保供应商的产品符合公司的生产要求。

5、研发模式

公司采取以市场为导向、以客户需求为核心的研发战略，形成了完整、高效的创新机制，建立了完善的研发管理制度。

公司的研发工作由研发中心承担，主要研发方向如下：

（1）不同类型芯片尤其是高端芯片的测试工艺难点的突破和具体测试方案的开发；

（2）各类基础性的测试技术的研发以及测试硬件的升级和改进；

（3）自动化生产、智能化生产等 IT 系统的研发。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为集成电路测试服务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”小类。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.4 集成电路制造”。

（1）行业的发展阶段

①中国台湾独立第三方测试企业：处于领先地位

中国台湾是最早形成规模化的独立第三方测试产业的地区，其拥有的第三方测试企业在数量、规模、技术和市场份额上都处于全球领先地位。其中京元电子、矽格、欣铨三家独立第三方测试企业是其中的代表性企业，在中国台湾地区测试市场的占有率合计超过 30%。

②中国大陆独立第三方测试企业：发展初期

从发展时间上看，中国大陆独立第三方测试行业起步较晚，目前规模位居前列的三家企业中，除了华岭股份成立时间相对较早外，公司和利扬芯片成立时间相对较晚。

从规模上看，上述三家企业与京元电子、矽格、欣铨等全球一流第三方测试企业在体量上差距较大。2022 年度，公司、利扬芯片及华岭股份的合计营业收入约为 14.61 亿元人民币，在中国大陆的测试市场份额仍较低，而 2022 年京元电子、矽格、欣铨的合计营业收入约在 160 亿元人民币左右，在中国台湾测试市场的市占率超过 30%。

因此，无论从成立时间及发展深度、测试设备等核心资产规模、营业收入规模及其市场占有率等角度看，中国大陆独立第三方测试厂商还处于发展的初期，测试所需核心设备等固定资产规模较小、市场渗透率较低，因此未来市场份额的提升空间广阔、发展潜力巨大。与此同时，中国大陆独立第三方测试企业积极加大测试研发投入，提升测试技术水平，提高测试服务质量以及提升测试服务效率，在集成电路测试市场的地位逐步提升，获得了客户的认可、信任和青睐。

（2）行业基本特点

“独立第三方测试服务”起源于集成电路行业起步早、基础牢、发展快、底蕴深厚，并处于行业领先地区的中国台湾，经过三十余年的发展，该商业模式在中国台湾已非常成熟，故“独立第三方测试服务”的商业模式符合行业的分工化、精细化的发展趋势，即设计、制造、封装、测试分工明确的发展趋势。

与“封测一体模式”相对比，“独立第三方测试服务模式”具备如下优点：

①独立第三方测试企业的测试结果相对中立客观

集成电路测试的初衷和目的是对设计阶段、晶圆制造阶段和封装阶段的工作进行检查，封测一体企业为客户提供封装和测试的服务，且其封装业务的营业收入占比相对更大，因此测试结果的中立性和客观性存在着一定的局限；独立第三方测试企业只从事测试业务，因此测试结果相对客观公正，在此方面更具获得客户的认可。

②独立第三方测试企业在技术专业性和效率上的优势相对明显

因为封测一体企业封装业务的占比相对于测试业务的占比更大，而独立第三方测试企业将全部的研发投入、设备采购、人员配置、厂房环境设置、信息技术处理以及资金都投向集成电路测试业务，因此独立第三方测试企业在测试专业程度、测试设备的种类和规模、测试效率和测试品质方面，优势均相对突出。

（3）主要技术门槛

①技术门槛

集成电路测试行业属于技术密集型行业，测试服务所需的技术含量较高，在测试方案开发能力、测试技术水平以及生产自动化程度三个方面均具备相对较高的门槛。

在测试方案开发方面，公司突破了 5nm-14nm 先进制程芯片、5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片以及高算力高性能芯片、车规及工业级高可靠性芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化替代。

在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。

在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

②人才门槛

集成电路产业属于智力密集型行业，人才是集成电路企业最关键的要素，人才的培